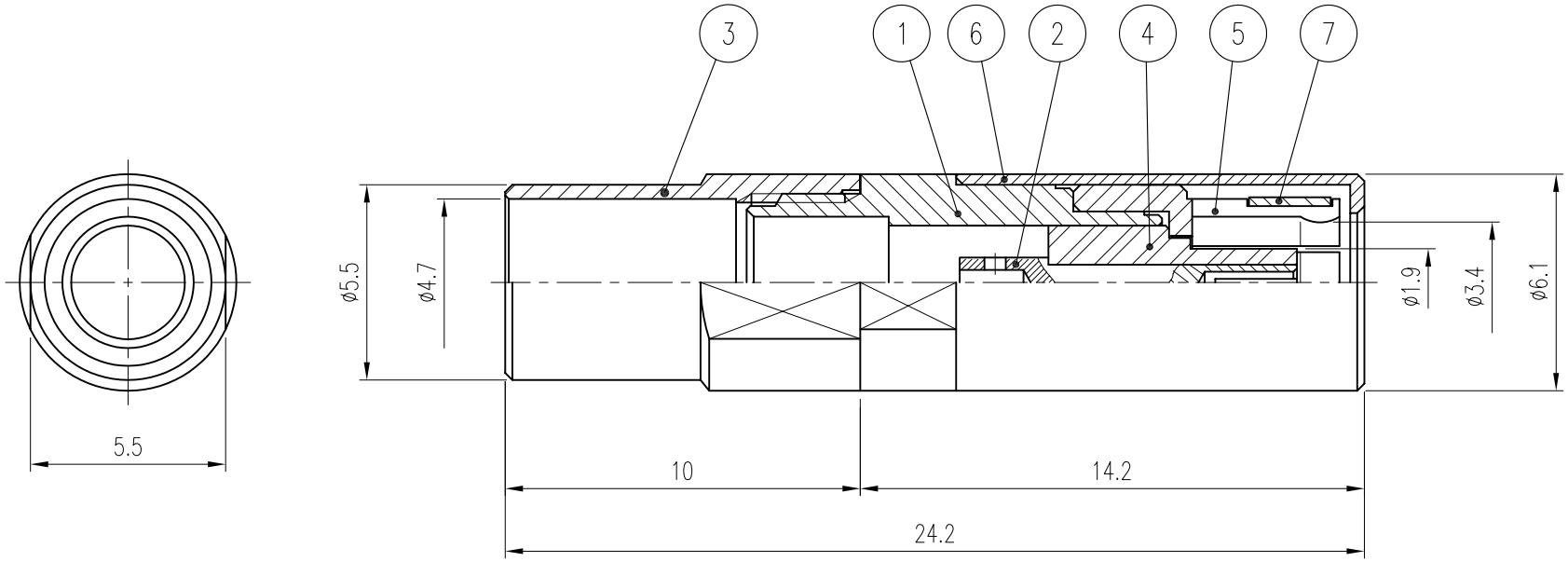
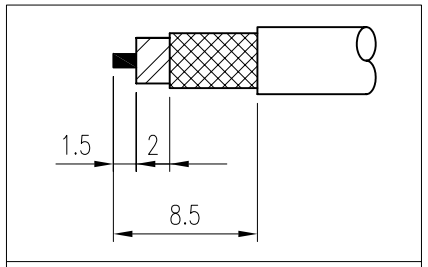
ST \ 가공										
ST(기존)										
ST(개선)										

수 정 내 용

부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일



품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
7	SPRING RING	1	BeCu	Gold Plate	DSR00004-5/1 (R3001)
6	CAP	1	MBsBD	Gold Plate	DCU00029-5/1 (K3018)
5	JACK	1	MBsBD	Gold Plate	DJA00029-5/1 (J3029)
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN01574-N/1 (H3154)
3	FERRULE	1	MBsBD	Gold Plate	DFE00143-5/1 (F3022)
2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT01993-5/1 (E3172)
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD02483-5/1 (D3178)



CABLE 탈피도

대체가능재질

공통공차
.* ±0.1
.** ±0.05

재질

열처리

보호피막처리

년월일 2007. 1. 3.

승인

검도

제도

작성부서 연 구 소

척도 4/1 단위 mm 중량

KJ COMTECH
KJ COMTECH CO.,LTD.

RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명 SMB50 CABLE PS MF141

A4

도번 CN01757-7/1

K315-099-000